

# Dienstleistungen und aktuelle Prüfverfahren des Prüflabors

Das Prüflaboratorium

„EMVCo- und DK-Prüflabor“ bei der S-Payment GmbH

besitzt die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018,

Funktionsprüfungen von Chipkarten mit Betriebssystem SECCOS im Prüfgebiet „Informationstechnik mit Unterkategorie Smart Cards“

durchzuführen.

Das Prüflabor bietet Prüfungen zur Erlangung einer

- a. DK Modulzulassung
- b. EMVCo Card Type Approval

Die nachfolgend aufgeführten Prüfverfahren sind auf aktuellem Stand und werden hiermit veröffentlicht.

## DK Modulzulassung

Im Rahmen der im DK Zulassungsverfahren sog. „*Funktionstests*“ wird durch das Berichten des Prüfvorgangs „*DK Testsuite 1*“ eine „*DK Modulzulassung*“ erlangt und von der DK Zulassungsstelle erteilt.

### Prüfverfahren zum Prüfvorgang „*DK Testsuite 1*“:

Titel des Prüfverfahrens	Version des Prüfverfahrens	Beschreibung des Prüfverfahrens	Anforderungen an den Prüfgegenstand
<b>DK Testsuite 1 - Funktionale Tests</b>	<b>1.3</b>	Kontaktbehaftete Tests von Standard- und Ergänzungskommandos und Kommandoübergreifende Tests gemäß DK Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt.
<b>DK Testsuite 1 - T=1 Tests</b>	<b>1.1</b>	Test der bidirektionalen kontaktbehafteten Schnittstelle der Chipkarte mit dem Übertragungsprotokoll T=1 gemäß DK Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt.
<b>DK Testsuite 1 - Recovery Tests</b>	<b>1.0</b>	Test eines konsistenten Datenzustands bei einem kontaktbehafteten Kommunikationsabbruch mit dem Terminal gemäß DK Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt.
<b>DK Testsuite 1 - Funktionale CL-Tests</b>	<b>1.3</b>	Kontaktlose Tests von Standard- und Ergänzungskommandos und Kommandoübergreifende Tests gemäß DK Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt und unterstützt zusätzlich die kontaktlose Schnittstelle.
<b>DK Testsuite 1 - T=CL Tests</b>	<b>1.2</b>	Test der bidirektionalen kontaktlosen Schnittstelle der Chipkarte mit dem Übertragungsprotokoll T=CL gemäß DK Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt und unterstützt zusätzlich die kontaktlose Schnittstelle.
<b>DK Testsuite 1 - Recovery CL-Tests</b>	<b>1.1</b>	Test eines konsistenten Datenzustands bei einem kontaktlosen Kommunikationsabbruch mit dem Terminal gemäß DK Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt und unterstützt zusätzlich die kontaktlose Schnittstelle.

## EMVCo Card Type Approval

Im Rahmen der im EMVCo Zulassungsverfahren sog. „*Card Functional Evaluation*“ wird durch das Berichten der Prüfvorgänge „*EMVCo Level 1 electrical and Protocol Testing*“ und „*EMVCo Level 2 CPA/CCD Testing*“ eine „*EMVCo Card Type Approval*“ erlangt und von der EMVCo Zulassungsstelle erteilt.

### Prüfverfahren zum Prüfvorgang „*EMVCo Level 1 electrical and Protocol Testing*“:

Titel des Prüfverfahrens	Version des Prüfverfahrens	Beschreibung des Prüfverfahrens	Anforderungen an den Prüfgegenstand
<b>EMVCo Level 1 - electrical Testing</b>	<b>1.3</b>	Kontaktbehaftete Tests der elektrischen Eigenschaften bei vorgegebenen Klimawerten (Temperatur, Luftfeuchte) gemäß EMV Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems und nach EMV Books 1 bis 4 inkl. Specification Bulletins umgesetzt.
<b>EMVCo Level 1 - Protocol Testing</b>	<b>1.4</b>	Test der bidirektionalen kontaktbehafteten Schnittstelle der Chipkarte mit dem Übertragungsprotokoll T=1 bei vorgegebenen Klimawerten (Temperatur, Luftfeuchte) gemäß EMV Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems und nach EMV Books 1 bis 4 inkl. Specification Bulletins umgesetzt.

### Prüfverfahren zum Prüfvorgang „*EMVCo Level 2 CPA/CCD Testing*“:

Titel des Prüfverfahrens	Version des Prüfverfahrens	Beschreibung des Prüfverfahrens	Anforderungen an den Prüfgegenstand
<b>EMVCo Level 2 CPA/CCD Testing</b>	<b>1.3</b>	Kontaktbehaftete Tests von Standard- und Ergänzungskommandos und Kommandoübergreifende Tests gemäß EMV Anforderungen.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems und nach EMV Books 1 bis 4 inkl. Specification Bulletins umgesetzt.

## Verwendete Abkürzungen

CCD	Common Core Definition
CPA	Common Payment Application
DAkKS	Deutsche Akkreditierungsstelle
DK	Die Deutsche Kreditwirtschaft
EA	European Accreditation
EMV	Eine Spezifikation für Zahlungskarten der drei namensgebenden Gesellschaften Europay (jetzt MasterCard Europe), MasterCard und Visa.
SECCOS	Secure Chip Card Operating System

## Definitionen

DK	Die Deutsche Kreditwirtschaft vertritt die Interessen der kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände in Deutschland, siehe <a href="http://www.die-dk.de">www.die-dk.de</a> .
EMVCo	EMVCo ist eine Evaluierungseinrichtung, welche von diversen internationalen Payment Systems gegründet wurde und gemeinsam betrieben wird, siehe <a href="http://www.emvco.com">www.emvco.com</a> .